

モバイル業界における世界最大の展示会

「Mobile World Congress 2013」に出展

～モバイル機器と非接触 IC 技術で創る便利で楽しい世界の創造をグローバル市場でアピール～

フェリカネットワークスは、2月25日からバルセロナで開催予定のモバイル業界における世界最大の展示会「Mobile World Congress 2013」（以下MWC）に出展します。昨年に続き、2度目の出展となります。

展示ブース内では、携帯電話と非接触 IC 技術を融合させて、世界で初めて商業化・普及を実現した「おサイフケータイ®サービス」の紹介とデモを行います。あわせて、世界標準規格の策定が進み、普及しつつある近距離無線通信技術 Near Field Communication（以下 NFC）への取り組みについて、展示を行う予定です。

主な展示内容

日本における圧倒的な実績

- 日本におけるおサイフケータイ対応携帯電話の普及、サービスの拡大に関してご紹介します。
- おサイフケータイ端末の先進的なユースケース紹介：おサイフケータイのシンククライアントリーダー/ライター端末としての活用をご紹介します。
- 導入事例：マクドナルドでのおサイフケータイによる決済およびクーポンサービスが普及。日本国内で1,500万人が利用している同サービスのビデオを上映し、デモをご覧頂きます。

グローバル市場向けソリューションの紹介

- 電子チケットソリューション
音楽コンサートやスポーツイベントなどのエンタテインメントチケット購入から入場までをスマートフォン1つで実現します。紙チケットに比べて、チケット配送コストの削減や、リーダー/ライターを使ったかざすだけの効率的な入場オペレーション、モバイルを活用した緊密なプロモーション戦略を実現するサービスのデモを行います。
- 事例紹介：ボードウォーク社、オーガス社での採用実績をご紹介します。
 - ボードウォーク社：2010年に採用後、累計250万枚以上の携帯電子チケット発券、運用の実績があります。
 - オーガス社：2012年10月より、おサイフケータイ向け電子チケットを採用しています。

日本で9年の実績をもつ当社の今後の展開

- 多様化するモバイル技術に対応したプラットフォームに対応
これまで日本で培ってきたFeliCaチップを搭載したおサイフケータイへのサービス提供に加え、非接触技術方式 NFC の TypeA/B 向けソリューション、QRコード、バーコードも包含したトータルモバイルソリューションへと進化させた当社のサービス、取り組みをご紹介します。
- 当社と協業し、開発中のサムスン電子 サンプルチップの展示
 - NFC コントローラー
 - NFC コントローラーおよびセキュリティ機能を備えた FeliCa SAM IC チップを1つのチップにパッケージ化した SiP
- 「NFC アクティブタグ」ソリューション
NFC 携帯と電子ペーパー付きアクティブタグを活用することで、リーダー/ライター導入費用およびネットワークコストをおさえることが可能です。NFC 搭載端末が増える中、セキュアなサービスを行えるソリューション案を展示します。

モバイル業界における世界最大級の展示会 Mobile World Congress 2013

- 概要: 携帯電話・モバイル業界の世界最大級のビジネスイベント。世界の主要携帯電話通信事業者、無線機器および端末メーカーをはじめコンテンツ/サービス、ソフトウェア開発、周辺機器、関連企業などの関係者が参加。期間中は展示会に加え、会議、セミナー等も開催される。
- 開催地(会場): スペイン バルセロナ “Fira Gran Via”
Av. Joan Carles I, 64, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain
- 開催日程: 2013年2月25日(月)～2013年2月28日(木) (4日間)
- 開場時間: 9時～19時(最終日のみ16時終了)
- 来場者実績: 67,000人以上 (MWC 2012実績)
- 出展者実績: 約1,500社 (MWC 2012実績)
- 主催: GSM Association ; GSMA Limited
- 公式サイト: <http://www.mobileworldcongress.com/>

※入場には、MWC事務局から入場パスをご購入いただく必要がございます。
<http://www.mobileworldcongress.com/passes-and-prices/>



フェリカネットワークスブースのご案内

開場全体



Hall 8.1



- フェリカネットワークスは、Hall8.1のJETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)が主催する"Japan Pavilion"ブース内にて出展いたします。
- 世界に先駆けて普及しております日本のおサイフケータイ端末インフラやサービスの広がりをご紹介しますと共に、グローバルに多様化するモバイル技術を幅広くカバーするトータルソリューションについて、デモを交え紹介します。また、現在サムスン電子にて開発中のNFC対応チップのサンプルを展示する予定です。

Hall 8.1

